

키모텍트™
고내구성보호필름
For Liquid Solder Resist

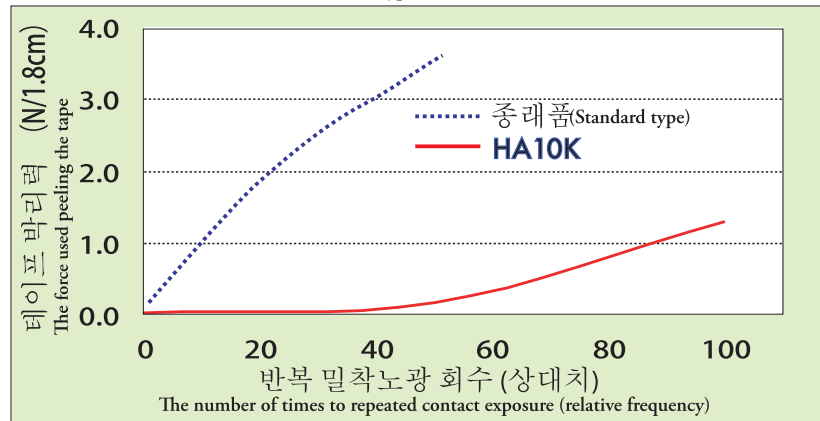


기본재료 두께 Base Film Thickness	점착 두께 Adhesive Thickness	세퍼레이터 두께 Release Liner Thickness
6 μm	4 μm	25 μm

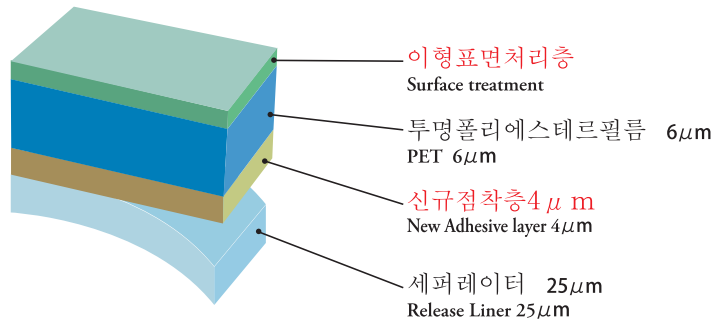
액상레지스트가 부착이 어려워져 클리닝도 용이해지고
끈적음이 남지 않아 재박리가 가능
종래품에 비해 액상레지스트가 부착이 어려워 양산 공정에 좋음

HA10K can be easily removed from the surface of the phototools and is repealable without any remnants of adhesive. Compared with standard type of KIMOTECT, "HA-10K" improves on its non-stick performance to liquid resist ink, and so it is especially suited for mass production.

이형 지속성의 비교 Comparison of durability of non-stick performance between standard type and HA-10K.



광경화수지에 밀착 노광을 반복하여 이형력 변화를 테이프 박리로 평가함
The peeling tape test : measures tape adhesion to the surface of HA10K after each 10 times of full contact exposures to Photopreactixe resin.



특성 Properties

	HA10K
전광선투과율(%)*1 Total Light Transmittance	91.4
자외선투과율*2(%/365nm) UV Light Transmittance	90.6
자외선투과율*2(%/420nm) UV Light Transmittance	91.2
Haze(%)*3	6.0
점착력 (대PET) Adhesive Force for PET	2.1N/25mm

*1:JIS-K7361-1에 준해서 측정함. 세퍼레이터는 포함되어 있지 않습니다.
*2:시마즈제작소재 UV-3101PC로 측정함. 세퍼레이터는 포함되어 있지 않습니다.
*3:JIS-K7136에 준해서 측정함. 세퍼레이터는 포함되어 있지 않습니다.
이 카탈로그에 기재된 데이터는 대표값이고 규격값이 아닙니다.
*1:JIS-K7361-1 without Release Liner.*2:Shimadzu UV-3101PC without Release Liner. *3:JIS-K7136 without Release Liner.

KIMOTECT